股票代码:688072 股票简称:拓荆科技 上市地点:上海证券交易所

拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要)

项目	交易对方
发行股份及支付现金购买资产	王世宽、夏小军、无锡芯聚管理咨询合伙企业(有限合伙)等34名交易对方
募集配套资金	不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者

二〇二六年七月

上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证预案内容及本预案摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司第一大股东国家集成电路基金、董事、高级管理人员承诺:如本次交易因本公司/本人涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司/本人不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;如本公司/本人未在两个交易日内提交锁定申请,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

截至本预案摘要签署日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,预案及本预案摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、高级管理人员保证预案及本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。

本预案摘要所述本项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证,也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。预案及本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得本公司董事会再次审议通过、股东会的审议通过、上海证券交易所的审核通过、中国证监会的同意注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况,及时披露相关信息,提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后,本公司经营与收益变化由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易事项时,除预案及本预案摘要内容以及同时披露的相关文件外,还应认真考虑预案及本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函,保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担相应的法律责任。

如本次交易所披露或提供的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让其在上市公司拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送账户信息的,授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

释 义

在本预案摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

一、一般名词释义		
预案	指	《拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》
预案摘要/本预案摘要	指	《拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要)》
重组报告书	指	《拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
本公司/公司/上市公司/拓荆科技	指	拓荆科技股份有限公司(股票代码:688072.SH)
无锡芯利	指	无锡尚积半导体科技股份有限公司
上海泰纳	指	上海泰纳微企业管理有限公司
无锡宽行	指	无锡宽行企业管理有限公司
标的公司	指	无锡尚积、上海泰纳微、无锡宽行
标的资产	指	无锡尚积92.97%股份、上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权
本次交易/本次重组	指	上市公司发行股份及支付现金购买无锡尚积92.97%股份、上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权并募集配套资金
交易对方	指	王世宽、夏小军、张燕、林春燕、无锡芯聚管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳君联高远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、无锡赛霖管理咨询合伙企业(有限合伙)、无锡芯智管理咨询合伙企业(有限合伙)、华奥商新交投(芜湖)产业链投资基金合伙企业(有限合伙)、无锡淡滨尼管理咨询合伙企业(有限合伙)、新佩嫔、无锡国联新创泰伯一期创业投资(有限合伙)、江苏无锡集成电路产业专项母基金(有限合伙)、珠海天一筑尚管理咨询合伙企业(有限合伙)、厦门润西南弘盛科创基金合伙企业(有限合伙)、广州科创智汇四号创业投资合伙企业(有限合伙)、扬州清怡创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡新创联尚创业投资合伙企业(有限合伙)、扬州弘志创业投资合伙企业(有限合伙)、西安君联南盈股权投资合伙企业(有限合伙)、南京建邺巨石科创成长基金(有限合伙)、无锡新新见科创投资创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳蓝点二号电子启思产业创业投资合伙企业(有限合伙)、广州穗开智造科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳昊瑞一号投资合伙企业(有限合伙)、宿迁产发科技股权投资基金(有限合伙)、深圳蓝点七号创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡新创联芯股权投资合伙企业(有限合伙)、钱庆军、王恒兰、全建国、南京芯笨股权投资合伙企业(有限合伙)、山东浪潮财鑫创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡点石共赢咨询服务合伙企业(有限合伙)
各方/交易各方	指	上市公司、交易对方、标的公司
双方/交易双方	指	上市公司、交易对方
国家集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
国投上海	指	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)
中微公司	指	中微半导体设备(上海)股份有限公司
无锡芯聚	指	无锡芯聚管理咨询合伙企业(有限合伙)
君联英迪	指	深圳君联英迪私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
无锡赛霖	指	无锡赛霖管理咨询合伙企业(有限合伙)
无锡芯智	指	无锡芯智管理咨询合伙企业(有限合伙)
华奥商新交投	指	华奥商新交投(芜湖)产业链投资基金合伙企业(有限合伙)
无锡淡滨尼	指	无锡淡滨尼管理咨询合伙企业(有限合伙)
泰伯一期	指	无锡国联新创泰伯一期创业投资(有限合伙)
无锡母基金	指	江苏无锡集成电路产业专项母基金(有限合伙)
珠海天一	指	珠海天一筑尚管理咨询合伙企业(有限合伙)
厦门润西南	指	厦门润西南弘盛科创基金合伙企业(有限合伙)
广州四号	指	广州科创智汇四号创业投资合伙企业(有限合伙)
扬州清怡	指	扬州清怡创业投资合伙企业(有限合伙)
新创联芯	指	无锡新创联芯创业投资合伙企业(有限合伙)
扬州弘志	指	扬州弘志创业投资合伙企业(有限合伙)
西安君联	指	西安君联南盈股权投资合伙企业(有限合伙)
南京巨石	指	南京建邺巨石科创成长基金(有限合伙)
新投新创	指	无锡市新吴区新投新创创业投资合伙企业(有限合伙)
蓝点二号	指	深圳蓝点二号电子启思产业创业投资合伙企业(有限合伙)
穗开智造	指	广州穗开智造科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)
宿迁产发	指	宿迁产发科技股权投资基金(有限合伙)
蓝点七号	指	深圳蓝点七号创业投资合伙企业(有限合伙)
新创联芯	指	无锡新创联芯股权投资合伙企业(有限合伙)
南京芯笨	指	南京芯笨股权投资合伙企业(有限合伙)
钱庆军	指	钱庆军(曾用名:钱庆)
点石共赢	指	无锡点石共赢咨询服务合伙企业(有限合伙)
发行股份购买资产定价基准日/定价基准日	指	上市公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日
报告期	指	2024年度、2025年度及2026年1-5月
交割日	指	本次交易标的资产全部过户至上市公司名下之日
过渡期	指	评估基准日至交割日之间的过渡期间
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	上市公司与王世宽等34名交易对方签署的附生效条件的《拓荆科技股份有限公司关于无锡尚积半导体科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	《拓荆科技股份有限公司章程》
《股东会议事规则》	指	《拓荆科技股份有限公司股东会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
元、万元、亿元	指	如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、与行业可或术语释义		
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System,微机电系统,是指融合微电子与微机械加工工艺制作的微型化器件系统,依托半导体光刻、薄膜沉积、刻蚀等晶圆制造技术,在硅、玻璃、石英等材料上制备微米级机械结构与配套电路
功率半导体	指	实现电能转换、调控的电力电子核心器件,包含硅基器件及SiC、GaN第三代宽禁带器件,广泛用于新能源车、光伏储能、工业电控等领域
射频芯片	指	处理高频无线信号的专用集成电路,采用GaAs、GaN等化合物工艺,应用于通信基站、雷达、物联网等场景
逻辑芯片	指	执行运算、控制、信号处理等逻辑运算功能的半导体芯片,通过晶体管组合形成与、或、非等基础逻辑单元,可完成数据计算、指令调度、系统控制等核心任务
存储芯片	指	用于持久或临时存放数字数据、程序代码的半导体芯片,核心功能为数据读写与保存
晶圆	指	在氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、清洗与抛光、金属化等特定工艺加工过程中的载片
晶圆制造、芯片制造	指	通过一系列特定的加工工艺,将半导体硅片加工制造成芯片的过程,一般分为前道晶圆制造和后道封装测试
先进封装	指	处于前道的封装形式和技术。目前,带有倒装芯片(FC)结构封装、晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)、硅通孔技术(TSV)、2.5D封装、3D封装等均被认为属于先进封装范畴
薄膜沉积	指	半导体前道工序之一,在硅片晶圆上沉积膜层以形成芯片微观电路的工艺,直接影响器件的性能与可靠性。薄膜沉积设备主要包括CVD(化学气相沉积)、ALD(原子层沉积)、PVD(物理气相沉积)等,是半导体制造工艺的关键步骤
刻蚀	指	半导体前道工序之一,以可控方式去除晶圆上特定材料层,以形成图形、结构或电路的技术,是半导体制造工艺的关键步骤
三维集成	指	通过垂直堆叠方式将多个晶圆、芯片或功能层进行空间集成,并依托硅通孔(TSV)、混合键合等高密度垂直互连技术实现层间电气连接与信号传输的半导体技术体系,涵盖2.5D中介层集成、3D晶圆堆叠、芯片堆叠、异构集成等主流技术路径
CVD	指	Chemical Vapor Deposition,化学气相沉积,是指化学气体或蒸汽在基底表面反应合成涂层或纳米材料的方法,是半导体工业中应用最为广泛的用来沉积多种材料的技术,包括大范围的绝缘材料、大多数金属材料和金属合金材料
ALD	指	Atomic Layer Deposition,原子层沉积,是指通过交替通入气态反应前驱体,使反应物在基底表面发生自限制表面化学反应,以单原子层为单位逐层生长薄膜的沉积工艺,具备原子级厚度控制精度与优异的台阶覆盖能力,可在高深宽比微观结构上实现保形沉积,是半导体先进制程中制备高精度介质层、阻挡层及功能薄膜的核心技术
PVD	指	Physical Vapor Deposition,物理气相沉积,是指通过高温真空蒸发、溅射产生金属蒸气,进而沉积形成附着力强的高纯金属或合金薄膜的工艺
SACVD	指	Sub-atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition,次常压化学气相沉积
HDPCVD	指	High Density Plasma Chemical Vapor Deposition,高密度等离子体化学气相沉积
Flowable CVD	指	Flowable Chemical Vapor Deposition,流动性化学气相沉积
Gap-Fill CVD	指	沟槽填充化学气相沉积,一类侧重填充晶圆高深宽比微小沟槽、孔洞结构的化学气相沉积工艺,包括SACVD、HDPCVD、Flowable CVD等类型
FSM & BSM	指	Front Side Metallization & Back Side Metallization,晶圆正面/背面金属化工艺,是指在硅化硅、硅功率器件晶圆正面有源区沉积金属薄膜,制作源极、漏极、栅极接触电极与金属布线层,完成正面电路互连;先减薄衬底,再在晶圆背部沉积多层金属薄膜,作为芯片散热层与底部导电焊接层
TSV	指	Through Silicon Via,是指直通硅晶穿孔封装,即硅通孔
TGV	指	Through Glass Via,是指穿透玻璃基板的垂直互连技术,即玻璃通孔
RDL	指	Redistribution Layer,重布线层/重分布层,是指半导体先进封装中的一项关键互连技术,通过在芯片表面或封装体内沉积额外的金属布线层(通常为铜)和介电层,将芯片上原有的输入/输出焊盘重新布局和连接到封装基板的凸点或焊球上,实现芯片引脚在水平方向的电气延伸与重新分配,从而突破芯片自身输入/输出布局和密度的限制
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International,国际半导体设备与材料协会

注:(1)本预案摘要所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标;(2)本预案摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,如无特殊说明,这些差异是由于四舍五入造成的。

重大事项提示

截至本预案摘要签署日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本预案摘要涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计机构、评估机构的审计、评估,相关资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易作价等将在重组报告书中予以披露,相关资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在差异,特提请投资者注意。

本公司提醒投资者认真阅读本预案摘要全文,并特别注意下列事项:

一、本重组方案简要介绍

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买无锡尚积82.97%股份、上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易,上市公司将直接及间接持有无锡尚积100%股份。

本次交易系我国本土核心半导体设备企业间的产业整合,契合国家集成电路产业发展战略及资本市场并购重组政策导向,顺应半导体设备国产替代核心趋势。本次交易是上市公司战行长期发展战略、迈向国际一流半导体设备企业的重要举措,将推动上市公司实现核心产品品类突破,加速向综合工艺解决方案服务商升级,优化收入结构、丰富盈利增长点,增强抗行业周期波动能力,依托国内产能的半导体设备市场空间持续提升盈利水平,有利于维护上市公司及全体股东利益。

上市公司与无锡尚积均聚焦半导体前道核心设备赛道,双方具备高度协同性与互补性。本次交易前,上市公司主营业务重点聚焦薄膜沉积设备和应用于三维集成领域的先进键合设备及配套量检测设备(以下统称“三维集成设备”),产品广泛应用于逻辑芯片、存储芯片、功率器件、Micro-OLED、硅光技术、图像传感器(CIS)等领域。其中,上市公司薄膜沉积设备主要聚焦PECVD、ALD和Gap-Fill CVD(包括SACVD、HDPCVD、Flowable CVD)等核心品类,系我国薄膜沉积设备行业龙头企业。无锡尚积主要产品包括PVD、CVD工艺薄膜沉积设备与刻蚀设备,目前产品和收入结构以PVD设备为主,其PVD设备产品在功率半导体、MEMS、射频芯片等细分领域具有国内领先地位和突出市场竞争优势;刻蚀领域目前聚焦干法刻蚀设备,主要应用于MEMS领域,并逐渐向功率器件、射频器件、先进封装等领域拓展;CVD设备,适用于射频、功率器件、先进封装等领域,目前处于产品研发和客户导入阶段。

本次交易将快速补齐上市公司核心产品线,完善对主流薄膜沉积工艺和三维集成领域关键设备的覆盖,进一步加强在半导体设备领域的战略布局。双方产品的下游应用场景交叉互补,可满足多领域客户一站式采购与联合工艺开发需求,有效提升客户绑定能力与市场覆盖广度。除产品领域的协同外,双方亦可在销售、供应链、研发等多个领域形成良好的协同效应,有效提升上市公司核心竞争力。

本次交易具体方案如下:

(一)重组方案概况

交易形式	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金			
交易方案简介	拓荆科技拟通过发行股份及支付现金的方式向王世宽、夏小军、无锡芯聚等34名交易对方购买其合计持有的无锡尚积82.97%股份、上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权,并募集配套资金。本次交易后,上市公司将直接及间接持有无锡尚积100%股份。			
交易价格	截至本预案摘要签署日,本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成,标的资产交易价格尚未最终确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易双方充分协商确定。			
交易标的一	名称	无锡尚积半导体科技股份有限公司		
	主营业务	无锡尚积主要从事半导体薄膜沉积与刻蚀设备的研发、生产和销售		
	所属行业	专用设备制造业(行业代码:C35)-半导体器件专用设备制造(行业代码:C3562)		
	其他	符合板块定位	√是 □否 □不适用	
		属于上市公司的同行业或上下游	√是 □否	
		与上市公司主营业务具有协同效应	√是 □否	
交易标的二	名称	上海泰纳微企业管理有限公司		
	主营业务	持股平台,除持有无锡尚积11.54%股份外无其他业务。		
	所属行业	专用设备制造业(行业代码:C35)-半导体器件专用设备制造(行业代码:C3562)		
	其他	符合板块定位	√是 □否 □不适用	
		属于上市公司的同行业或上下游	√是 □否	
		与上市公司主营业务具有协同效应	√是 □否	
交易标的三	名称	无锡宽行企业管理有限公司		
	主营业务	持股平台,除持有无锡尚积5.49%股份外无其他业务。		
	所属行业	专用设备制造业(行业代码:C35)-半导体器件专用设备制造(行业代码:C3562)		
	其他	符合板块定位	√是 □否 □不适用	
		属于上市公司的同行业或上下游	√是 □否	
		与上市公司主营业务具有协同效应	√是 □否	
交易性质	构成关联交易		□是 √否	
	构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组		□是 √否	
	构成重组上市		□是 √否	
本次交易有无业绩补偿承诺	本次交易业绩承诺和补偿具体方案将由上市公司与相关交易对方在审计、评估工作完成后按照中国证监会、上交所的相关规定另行协商确定,业绩承诺义务人及具体方案最终以签署的业绩承诺及补偿协议为准。			
本次交易有无减值补偿承诺	截至本预案摘要签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成,本次交易的最终交易价格、发行股份及现金支付比例尚未确定。上市公司与交易对方将在标的公司审计、评估工作完成之后,协商确定本次交易的具体方案,并在重组报告书中予以披露。			
其他需特别说明的事项	无。			

(二)交易标的的评估或估值情况

截至本预案摘要签署日,标的公司的审计和评估工作尚未完成,本次交易的最终交易价格、发行股份及现金支付比例尚未确定。上市公司与交易对方将在标的公司审计、评估工作完成之后,协商确定本次交易的具体方案,并在重组报告书中予以披露。

(三)本次重组的支付方式

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡尚积82.97%股份、上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权,交易对方各自取得的股份对价和现金对价支付比例和支付金额待标的公司审计、评估完成后,由上市公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日发行股份及支付现金购买资产的发行价格为383.57元/股,不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%,最终发行数量以经中国证监会同意注册的发行数量为准。

项目	交易对方
发行股份及支付现金购买资产	王世宽、夏小军、无锡芯聚管理咨询合伙企业(有限合伙)等34名交易对方
募集配套资金	不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者

(四)发行股份情况

股票种类	人民币普通股A股	每股面值	1.00元
定价基准日	上市公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日	发行价格	383.57元/股,不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%
发行数量	截至本预案摘要签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成,具体交易价格尚未确定,因此上市公司向交易对方发行的股份数量尚未确定。向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。发行对象发行股份的数量应为整数,精确至股。按上述公式计算得出的“发行数量”按照向下取整精确至股,不足一股的缩分计入上市公司的资本公积金。 本次发行的发行数量以上交所审核通过以及中国证监会同意注册的股数为准。在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项,则将根据发行价格的调整,对发行数量作相应调整。		
是否设置发行价格调整方案	□是 √否		
锁定期安排	交易对方通过本次交易取得的上市公司新增发行的股份,自新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起12个月内不得上市交易或转让;但是,若交易对方取得新增股份时,交易对方对用于认购新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月的,则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起36个月内不得上市交易或转让。若交易对方属于私募投资基金且于上市公司关于本次交易的首次董事会决议公告时交易对方对用于认购新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满48个月的,则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起6个月内不得上市交易或转让。本次交易实施完毕后,交易对方所持新增股份由于上市公司派息、送股、转增股本或配股等原因而增加的,该等增加的股份亦应遵守上述股份限售安排。如前述关于新增股份的锁定期承诺与届时有效的相关法律法规或证券监管机构的最新监管意见不相符的,交易对方将根据相关法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。		

二、本次重组募集配套资金情况的简要介绍

(一)本次重组募集配套资金使用

募集配套资金金额	募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行股份数量不超过本次募集配套资金所涉股份发行前上市公司总股本的30%,最终发行数量以经中国证监会同意注册的发行数量为准。
发行方式	向特定对象发行。
发行对象	不超过35名符合条件的特定对象。
募集配套资金安排	本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用、补充标的公司流动资金、偿还债务或标的公司项目建设等。募集配套资金具体用途及金额将在交易报告书中予以披露。在本次发行股份募集配套资金到位之前,上市公司根据实际情况以自筹资金先行支付,待募集资金到位后再予以置换。如上述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

(二)发行股份募集配套资金的具体情况

股票种类	人民币普通股A股	每股面值	1.00元
定价基准日	本次募集配套资金发行股份的发行期首日	发行价格	发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得上交所审核通过并经中国证监会予以注册后,由上市公司董事会根据股东会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。
发行数量	募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%,最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。		
锁定期安排	本次募集配套资金的认购方所认购的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。 上述锁定期内,募集配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因持有的上市公司股份,同时遵照上述锁定期进行锁定。如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门的最新监管意见不符,上市公司将根据监管部门的最新监管意见不符的规定,对有关锁定期安排予以调整。		

三、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司主营业务的影响

自成立以来,上市公司秉承“以技术进步为核心竞争力的发展机遇,始终坚持自主研发、自主创新,以“建立世界领先的半导体设备公司”为愿景,通过在薄膜沉积设备领域、三维集成领域的技术积累和快速发展,已经成为国内半导体设备行业的领军企业。

上市公司与无锡尚积同属于半导体设备企业,产品线高度互补,具有极佳的协同发展前景。在薄膜沉积领域,上市公司深耕薄膜沉积设备行业多年,已形成PECVD、ALD和Gap-Fill CVD等多个核心品类的成熟产品线,具备良好市场口碑与市场头部地位;无锡尚积及核心团队则长期聚焦PVD设备研发创新,是国内PVD设备领域知名企业,拥有成熟量产机型与核心工艺技术。通过本次交易,上市公司将快速获得成熟可靠的PVD工艺与技术,补齐薄膜沉积设备领域核心产品矩阵,完善对主流薄膜沉积工艺的覆盖。

在三维集成领域,上市公司结合新的技术趋势和市场需求,积极布局三维集成设备,成功研发并推出了应用于三维集成领域的先进键合设备及配套量检测设备。标的公司的PVD设备和刻蚀设备亦可应用于三维集成领域的RDL、TSV、TGV等核心工艺环节,覆盖先进存储、先进逻辑和先进封装的下一代产品工艺需求。本次交易完成后,上市公司将形成覆盖薄膜沉积、刻蚀、键合、检测的成套三维集成设备产品线,满足客户一站式采购与联合工艺开发需求,强化整体方案竞争力,提升客户粘性与单客产价值量。

本次交易是上市公司聚焦主业、围绕半导体设备这一核心业务不断延伸拓展的战略举措。上市公司与无锡尚积产品下游应用场景交叉互补,可满足多领域客户一站式采购与联合工艺开发需求,有效提升客户绑定能力与市场覆盖广度。除产品领域的协同外,双方亦可在销售、供应链、研发等多个领域形成良好的协同效应,有效提升上市公司核心竞争力。

(二)本次交易对上市公司股权结构的影响

截至本预案摘要签署日,上市公司无控股股东、实际控制人。鉴于本次交易的标的资产交易价格尚未确定,上市公司在本次交易前后的股权变动情况尚无法准确计算。经初步测算,本次交易完成后,上市公司仍无实际控制人,本次交易不会导致上市公司控股权发生变更。上市公司将在审计、评估等相关工作完成后,就本次交易对上市公司股权结构的影响进行具体分析,并在重组报告书中予以披露。

(三)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易完成后,上市公司的总资产、营业收入等将进一步增长,持续经营能力进一步增强。鉴于与本次交易相关的审计、评估等工作尚未最终完成,尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析,上市公司将在相关审计、评估等工作完成后,在重组报告书中就本次交易对上市公司盈利能力的影响进行详细测算并披露。

七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况

(一)本次交易已履行的决策程序和批准情况

截至本预案摘要签署日,本次交易已履行的决策程序及批准包括:

1、上市公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》;

2、本次交易方案已取得上市公司控股5%以上股东的原则性意见;

3、本次交易相关议案已经上市公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

(二)本次交易尚需履行的决策程序和批准情况

截至本预案摘要签署日,本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于:

1、本次交易涉及的标的资产审计、评估工作完成后,上市公司将再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案;

2、本次交易正式方案经交易对方内部有权机构审议通过;

3、上市公司股东会审议通过本次交易方案;

4、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册;

5、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的境内外批准、核准、备案或许可(如适用)。

本次交易方案在取得有关主管部门的批准、审核通过或同意注册前,不得实施。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册,以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

五、本次交易的性质

(一)本次交易预计不构成重大资产重组

截至本预案摘要签署日,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定,本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

(二)本次交易预计不构成关联交易

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。本次发行股份及支付现金购买资产完成后预计无交易对方持有上市公司股份超过5%。根据《股票上市规则》的有关规定,本次交易预计不构成关联交易。

(三)本次交易不构成重组上市

最近36个月内,上市公司均无实际控制人。本次交易前后,上市公司均不存在控股股东和实际控制人,本次交易不会导致上市公司控制权变更。根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重组上市。

六、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司主营业务的影响

自成立以来,上市公司秉承“以技术进步为核心竞争力的发展机遇,始终坚持自主研发、自主创新,以“建立世界领先的半导体设备公司”为愿景,通过在薄膜沉积设备领域、三维集成领域的技术积累和快速发展,已经成为国内半导体设备行业的领军企业。

上市公司与无锡尚积同属于半导体设备企业,产品线高度互补,具有极佳的协同发展前景。在薄膜沉积领域,上市公司深耕薄膜沉积设备行业多年,已形成PECVD、ALD和Gap-Fill CVD等多个核心品类的成熟产品线,具备良好市场口碑与市场头部地位;无锡尚积及核心团队则长期聚焦PVD设备研发创新,是国内PVD设备领域知名企业,拥有成熟量产机型与核心工艺技术。通过本次交易,上市公司将快速获得成熟可靠的PVD工艺与技术,补齐薄膜沉积设备领域核心产品矩阵,完善对主流薄膜沉积工艺的覆盖。

在三维集成领域,上市公司结合新的技术趋势和市场需求,积极布局三维集成设备,成功研发并推出了应用于三维集成领域的先进键合设备及配套量检测设备。标的公司的PVD设备和刻蚀设备亦可应用于三维集成领域的RDL、TSV、TGV等核心工艺环节,覆盖先进存储、先进逻辑和先进封装的下一代产品工艺需求。本次交易完成后,上市公司将形成覆盖薄膜沉积、刻蚀、键合、检测的成套三维集成设备产品线,满足客户一站式采购与联合工艺开发需求,强化整体方案竞争力,提升客户粘性与单客产价值量。

3、拓展下游应用场景,提升主流市场覆盖率

CVD、ALD和PVD工艺广泛覆盖半导体各类制造场景,但各设备企业技术路线与产品布局存在差异,尤其在高速成长期一般会依托自身优势技术沉淀聚焦部分细分应用赛道。上市公司CVD和ALD设备目前主要应用于逻辑芯片、存储芯片、功率器件、Micro-OLED、硅光技术、图像传感器(CIS)等领域;无锡尚积PVD和刻蚀设备则在MEMS、功率半导体、射频芯片等特色工艺领域应用占比较高,积累了深厚技术实力与客户资源。双方业务领域交叉互补,本次交易后上市公司可快速切入特色工艺领域,丰富收入结构,加强对重要细分领域的覆盖,提升上市公司市场占有率,巩固行业领先地位。

4、实现双方协同发展,提升上市公司业绩规模和未来盈利能力

上市公司与标的公司作为同行业企业,具备多维度协同效应。在产品端,双方可打造金属薄膜和介质薄膜成套解决方案,更好满足高端客户需求与设备集成化的行业趋势。在研发端,双方可共享底层技术平台、仿真模型与测试验证体系,双向复用工艺验证经验,提升研发效率、减少重复投入;同时上市公司可利用自身技术积累和客户资源,帮助标的公司产品在逻辑、存储等集成电路应用领域加速验证。在销售端,双方核心产品应用场景相似,可通过共享客户资源、实现交叉销售提升单客产销售量;同时,上市公司通过本次交易将进一步增强薄膜沉积和三维集成设备领域整体解决方案能力,有利于上市公司的客户开拓与服务。在供应链端,双方可通过集中采购增强议价能力、实现降本增效,并整合各自供应链优势,强化供应链安全与稳定性。

本次交易完成后,无锡尚积将成为上市公司控股子公司,上市公司可充分发挥自身的资本平台优势、规范化运营管理经验与成熟的客户端销售渠道对其进行赋能,提升其在细分半导体设备领域的技术产业化能力、批量交付能力与市场影响力。通过双方业务协同合力,上市公司能够构建覆盖更全面的产品组合、丰富收入结构与业务增长点,扩大优质客户群体覆盖范围,拓宽长期成长空间。本次交易将增强上市公司的综合竞争实力、市场拓展能力、周期抗风险能力与持续发展能力,进一步提升公司核心竞争力及全体股东利益。

(二)本次交易标的公司符合科创板定位、与上市